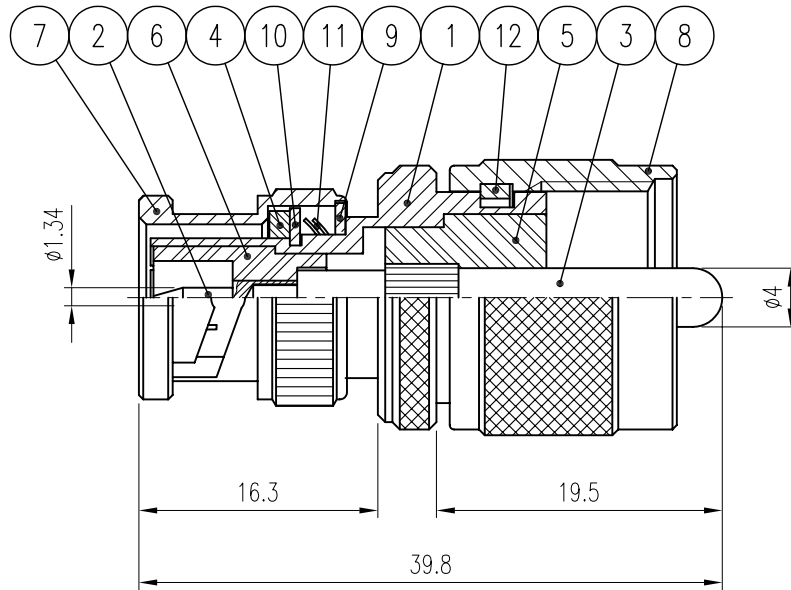


수 정 내 용										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
가공														
ST(기준)														
ST(개선)														



12	SPRING RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00028-N5/1 (RA002)
11	SPRING RING	2	BeCu	Nickel Plate	DWA00065-N45/1 (R6001)
10	WASHER	2	BsS	Nickel Plate	DWA00016-N5/1 (Q6002)
9	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00015-N5/1 (Q6001)
8	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00056-135/1 (KA002)
7	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00044-135/1 (K6001)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00575-N/1 (HA045)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00621-N/1 (HA044)
4	GASKET	1	SILICON		DIN00470-N/1 (HA029)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00617-15/1 (EA081)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00601-135/1 (EA033)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DAD00037-135/1 (DA039)

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2000. 2. 2.					 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
	승인								
재질	검도					도명 BNCP-UHFP			
	재도								
열처리	작성부서 연 구 소					도번 AD00054-7/1 K361-581-000			
보호피막처리	적도 4/1		단위 mm	총량					